

技術資料

FeedBond®EP-30-UF3B

底部填充絕緣膠

簡介:

FeedBond®EP-30-UF3B 為單組分熱固化粘合劑，專為電子元件底部填充、保護和封裝而設計。具有良好的填充速度，應用於 BAG/CSP/WLP 表現出良好的附著力。

特徵:

- 優秀的浸透和填充速度。
- 可低溫快速固化。
- 優秀的可靠性和接著強度。

硬化前特性		測試條件	測試方法
外觀	黑色	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm 黏度升高 25%@ 5rpm	FT-P006 FT-P024 FT-P018
黏度 @ 25°C	1000 cps		
使用壽命 @ 25°C	48 小時		
保存期限 @ -20°C	4 個月		
硬化條件		測試條件	測試方法
標準固化條件		135°C 20 分鐘 (依應用材料的狀態及升溫速率增減時間)	(烘箱)
建議填充使用溫度(出膠口/平台)		75°C	
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	>4kg/die	晶片尺寸 45*45mil ,PCB 板材 烘箱固化 135°C 20 分鐘	FT-M012

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

底部填充絕緣膠

物理化學性質	測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度(Tg) 111 °C	DMA 3 點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數 < Tg 48 ppm/°C > Tg 206 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數 @25°C 2083 MPa @150°C 16 MPa @250°C 19 MPa	DMA 3 點彎曲模式試片厚度 <1.6 mm	FT-M019

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(一般包裝回溫時間60分鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C或-40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）